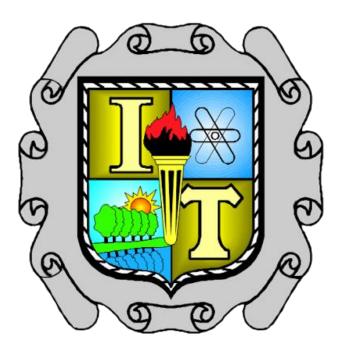
Arquitectura de computadoras

17:00 - 18:00

Reporte práctica #2

Instituto Tecnológico de Saltillo



Tipos de procesadores

William Alfonso Quistian Quistian 21051494

10 de marzo de 2023

Intel Celeron D 352 SL96P

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos: 1

• Frecuencia básica del procesador: 3.20

GHz

Caché: 512 KB L2 Cache
Velocidad del bus: 533 MHz

Paridad FSB: NoTDP: 86 W

• Rango de voltaje VID: 1.25V-1.325V

Información complementaria

• Opciones integradas disponibles: Yes

Especificaciones de memoria

• Extensiones de dirección física: 32-bit

• Compatible con memoria ECC: No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles: PLGA775

TCASE: 69.2°C

Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento: 81 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador: 188 million



Información general

Tipo: CPU / Microprocesador

• Familia: Intel Celeron

 Número de pieza: BX80530F1300256 / RK80530RY013256

• Marcas del procesador: 1300/256/100/1.5

Frecuencia (GHz): 1.3

Velocidad del bus (MHz): 100

multiplicador de reloj: 13

• Tipo de paquete: FC-PGA2 de 370 pines

Tipo de socket: Socket 370

Arquitectura / Microarquitectura / Otro

CPU ID: 06B1h

Core Stepping: A1

Next Stepping: QKE0

Next Production Stepping: SL6C7

Núcleo del procesador: Tualatin-256

Tecnología de fabricación: 0,13

Número de núcleos: 1

Tamaño de caché L2 (KB): 256

Features: MMX / SSE

Voltaje de núcleo (V): 1.5

Temperatura de la caja (°C): 71





Intel Celeron SL5ZF

información general

• Tipo: CPU / Microprocesador

• Familia: Intel Celeron

número de procesador: 1000A

Número de pieza: BX80530F1000256

Marcas del procesador: 1000A/256/100/1.475

Frecuencia (GHz): 1

• Velocidad del bus (MHz): 100

multiplicador de reloj: 10

Tipo de paquete: FC-PGA2 de 370 pines

Tipo de socket: Socket 370

Arquitectura / Microarquitectura / Otro

• CPU ID: 06B1h

Núcleo escalonado: A1

Núcleo del procesador: Tualatin-256

Tecnología de fabricación: 0,13

Número de núcleos: 1

Tamaño de caché L2 (KB): 256

Features: MMX / SSE

Voltaje de núcleo (V):1.475

Temperatura de la caja (°C): 69



Intel Celeron SL6RM

Información general

Tipo: CPU / Microprocesador

• Familia: Intel Celeron

 Número de pieza: BX80530F1100256 / RK80530RY005256

Frecuencia (GHz): 1.1

Velocidad del bus (MHz): 100

multiplicador de reloj: 11

Tipo de paquete: FC-PGA2 de 370 pines

Tipo de socket: Socket 370

Arquitectura / Microarquitectura / Otro

CPU ID: 06B4h

Núcleo escalonado: B1

Núcleo del procesador: Tualatin-256

Tecnología de fabricación (micras): 0,13

Número de núcleos: 1

Tamaño de caché L2 (KB): 256

Features: MMX / SSE

Voltaje de núcleo (V): 1.5

Temperatura de la caja (°C): 69

• Potencia de diseño térmico (vatios): 28,9



Intel Pentium SL4MB

información general

• Tipo: CPU / Microprocesador

• Familia: Intel Pentium III

número de procesador: 800EB

Número de pieza: BX80526C800256E

Marcas del procesador: 800EB/256/133/1.7V

Frecuencia (MHz): 800

Velocidad del bus (MHz): 133

multiplicador de reloj: 6

Tipo de paquete: FC-PGA de 370 pines

Tipo de socket: Socket 370

Arquitectura / Microarquitectura / Otro

• ID de CPU: 0686h

Escalonamiento del núcleo: cCO

• Núcleo del procesador: Coppermine

Tecnología de fabricación (micras): 0,18

Número de núcleos: 1

Tamaño de caché L2 (KB): 256

Features: MMX / SSE

Voltaje de núcleo (V): 1.7

Temperatura de la caja (°C): 80



Intel Pentium 531 SL9CB

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos: 1

Frecuencia básica del procesador: 3.00 GHz

• Caché: 1 MB L2 Cache

Velocidad del bus: 800 MHz

Paridad FSB: No

TDP: 84 W

Rango de voltaje VID: 1.200V-1.425V

Información complementaria

Opciones integradas disponibles: Yes

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles: PLGA775

TCASE: 67.7°C

Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento: 112 mm2

• Cantidad de transistores de chip de procesador:

125 million



Intel Pentium 4

Especificaciones sobre rendimiento

- Cantidad de núcleos 1
- Frecuencia básica del procesador 2,80 GHz
- Caché 512 KB L2 Cache
- Velocidad del bus 533 MHz
- Paridad FSB No
- TDP 68,4 W
- Rango de voltaje VID 1.340V-1.525V

Información adicional

• Opciones integradas disponibles Yes

Especificaciones del paquete

- Zócalos compatibles PPGA478
- TCASE 70°C
- Tamaño de paquete 35mm x 35mm
- Tamaño de chip de procesamiento 131 mm2
- Cantidad de transistores de chip de procesador 55 million



Intel Xeon E4

Especificaciones sobre rendimiento

Cantidad de núcleos: 1

Frecuencia básica del procesador: 3,00 GHz

• Caché: 2 MB L2 Cache

Velocidad del bus: 800 MHz

Paridad FSB: Yes

TDP: 110 W

Rango de voltaje VID: 1.2875V-1.3875V

Información adicional

Opciones integradas disponibles: No

• Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física: 32-bit

Compatible con memoria ECC: No

Especificaciones del paquete

Zócalos compatibles: PPGA604

TCASE: 72°C

• Tamaño de paquete: 42.5mm x 42.5mm

• Tamaño de chip de procesamiento: 135 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador: 169 million



Intel Pentium 4417U

Especificaciones de la CPU

- Cantidad de núcleos: 2
- Cantidad de subprocesos: 4
- Frecuencia básica del procesador: 2.30 GHz
- Caché: 2 MB Intel® Smart Cache
- Velocidad del bus: 4 GT/s
- TDP: 15 W
- Frecuencia de descenso de TDP configurable: 800 MHz
- Descenso de TDP configurable: 12.5 W

Especificaciones de memoria

- Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 32 GB
- Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
- Cantidad máxima de canales de memoria: 2
- Máximo de ancho de banda de memoria: 34.1 GB/s
- Compatible con memoria ECC: No

Especificaciones de paquete

- Zócalos compatibles: FCBGA1356Máxima configuración de CPU: 1
- T_{JUNCTION}: 100°C
- Tamaño de paquete: 42mm X 24mm

AMD Ryzen 7 3700U

Especificaciones generales

- Plataforma: Computadora portátil
- Familia de productos: AMD Ryzen™ Processors
- Línea de productos: AMD Ryzen™ 7 Mobile Processors with Radeon™ RX Vega Graphics
- N.° de núcleos de CPU: 4
- N.° de subprocesos: 8
- Reloj de aumento máx: Hasta 4.0GHz
- Reloj base: 2.3GHzCaché L1 total: 384KB
- Caché L2 total: 2MBCaché L3 total: 4MB
- TDP/TDP predeterminado: 15W
- AMD Configurable TDP (cTDP): 12-35W
- Processor Technology for CPU Cores: 12nm
- Desbloqueados: No
- Paquete: FP5
- Temp. Máx: 105°C
- Fecha de lanzamiento: Q1 2019
- *Compatible con SO
 - Windows 11 Edición de 64-bits
 - Windows 10 edición de 64·bits
 - o RHEL x86 edición de 64·bits
 - Ubuntu x86 edición de 64·bits
 - *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante.

